

我國3D IC關鍵設 備零組件廠商 發展動向

作者：陳慧娟

執行單位：財團法人金屬工業研究發展中心

中華民國一〇三年十二月

目錄

■ 摘要	1
■ 前言	2
■ 黃光製程設備廠商動向	3
■ 乾式蝕刻製程設備廠商動向	5
■ 溼式蝕刻/清潔製程設備廠商動向	6
■ 鍍膜製程設備廠商動向	7
■ 貼合製程設備廠商動向	7
■ 封測製程設備廠商動向	9
■ 結論	10

我國 3D IC 關鍵設備零組件廠商發展動向

金屬中心 MII 產業分析師 陳慧娟

摘要：

在討論半導體產業的發展時，普遍都會聚焦在如何延續摩爾定律 (Moore's law)。摩爾定律的延續其實可以分為兩個面向來看，一個面向是技術，內容為單位晶片內電晶體數量每十八個月會增加一倍；另一個面向是成本，內容為 IC 製作成本每十八個月會降低一半。未來若能同時符合經濟效益與產品效能的成長，就是半導體產業持續發展的重要關鍵。

台灣有完整的半導體上中下游垂直供應鏈，很適合發展 3D IC 技術產品，有利半導體產業串連與技術扎根。故在 3D IC 技術發展成熟前，本土設備與終端廠商投入研發，可降低台灣整體設備、製程成本並掌握自主技術，進而加速台灣在 3D IC 產業的量產時程。相信這是讓台灣半導體產業走出傳統代工模式的契機，藉由技術扎根與永續發展並讓台灣在未來全球半導體技術中扮演更重要角色。

《我國 3D IC 關鍵設備零組件廠商發展動向》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>